

高品質・極低スパッタ溶接システム

直流アルミ溶接

最大電流UP

最大
300A

- ・ Push Arcにより、最大電流を2倍にUP
- ・ 溶接速度と適応板厚が大幅向上

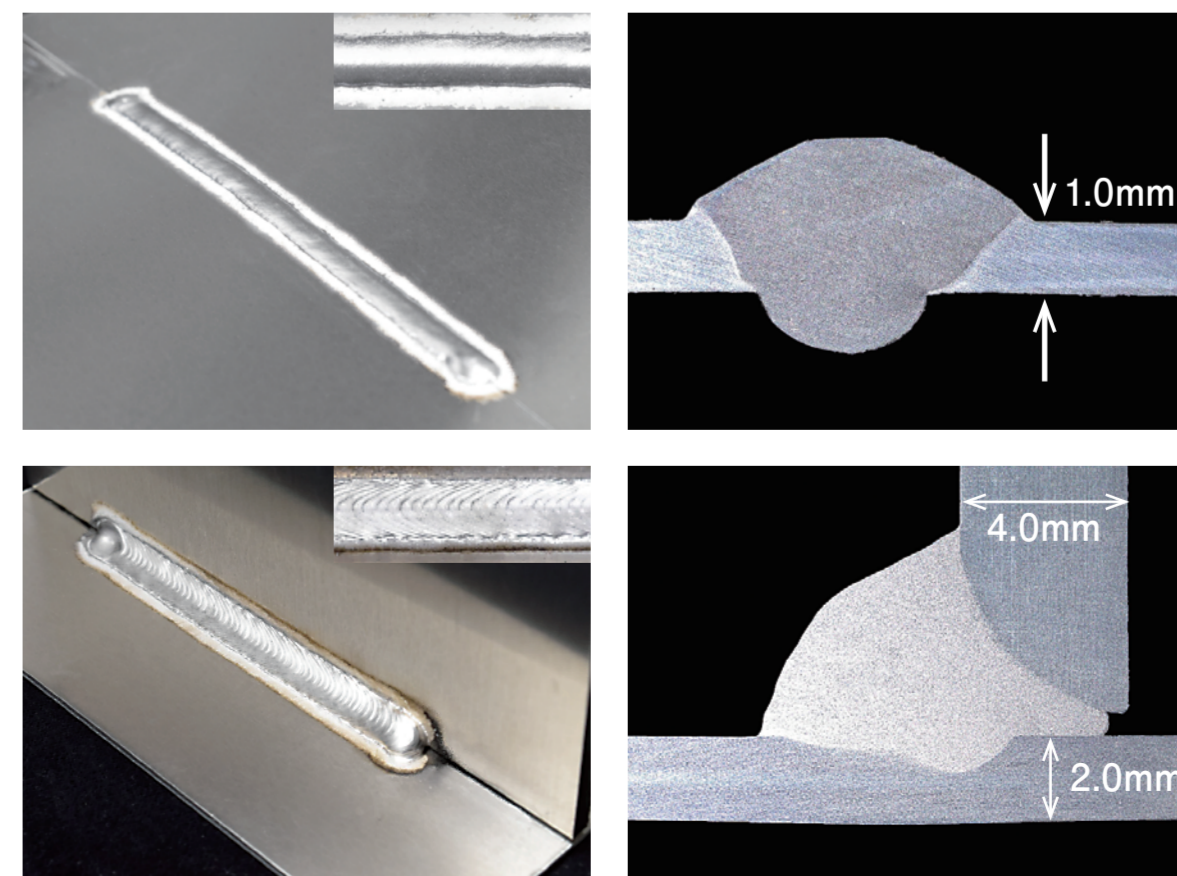
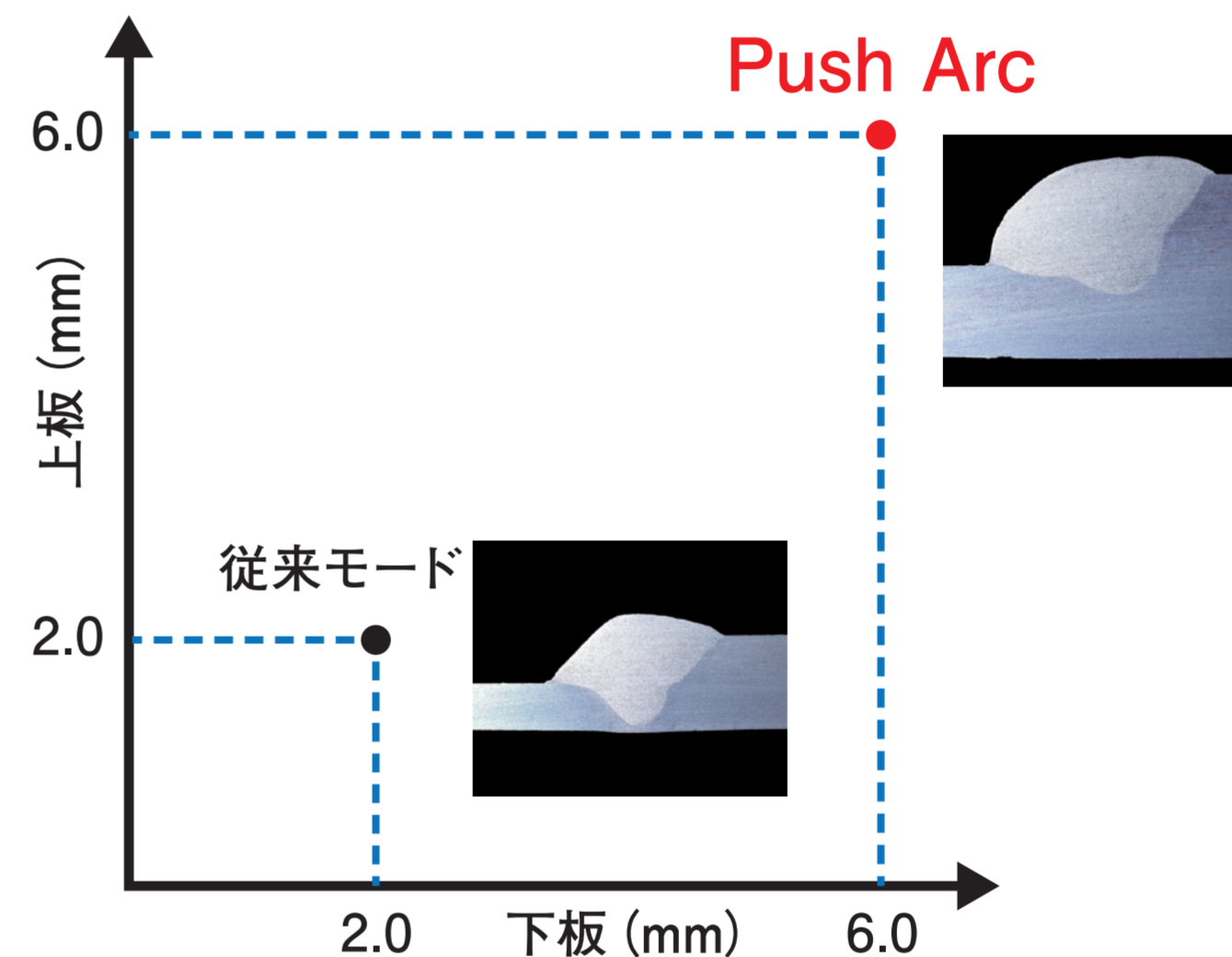
交流アルミ溶接

極低入熱

- ・ 溶落ちせずに、極薄板の溶接を実現

高溶着でギャップ裕度拡大

- ・ 板厚違い、ギャップがある溶接でも簡単に溶接可能
- ・ シンクロフィードパルスとの組合せで、適応範囲拡大



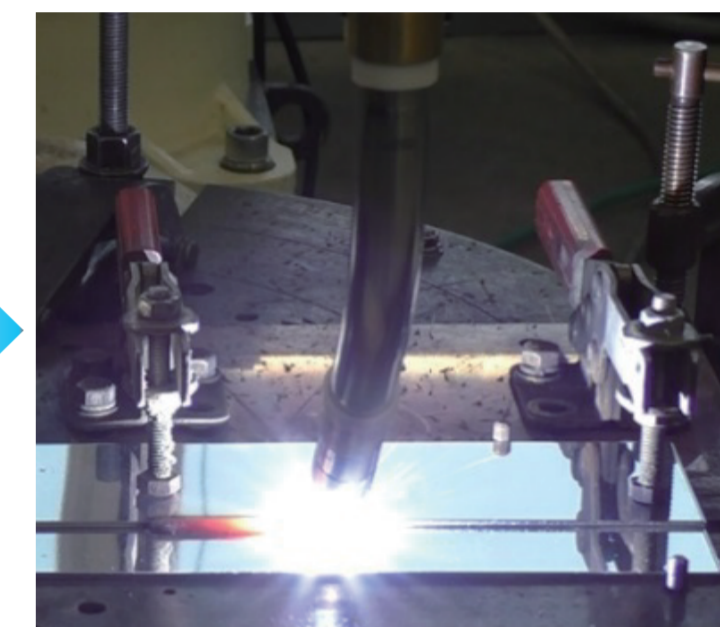
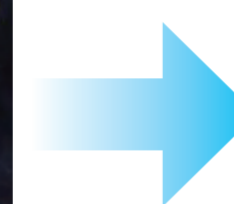
シンクロフィード・エボリューション

スパッタを最大99%低減

- ・ワイヤ送給と電流波形を高速に同期制御
- ・極低スパッタ溶接によるスパッタ除去工程の撲滅



従来溶接



シンクロフィード

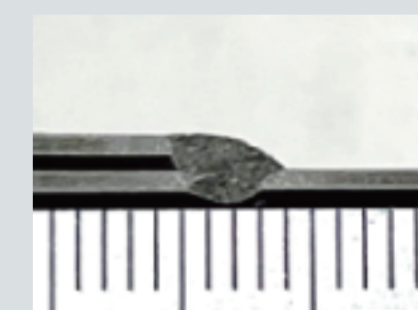
Push Arcプロセス

- ・フラットなビード外観でギャップ裕度が向上
- ・複数台での同時溶接でも極低スパッタを実現

従来

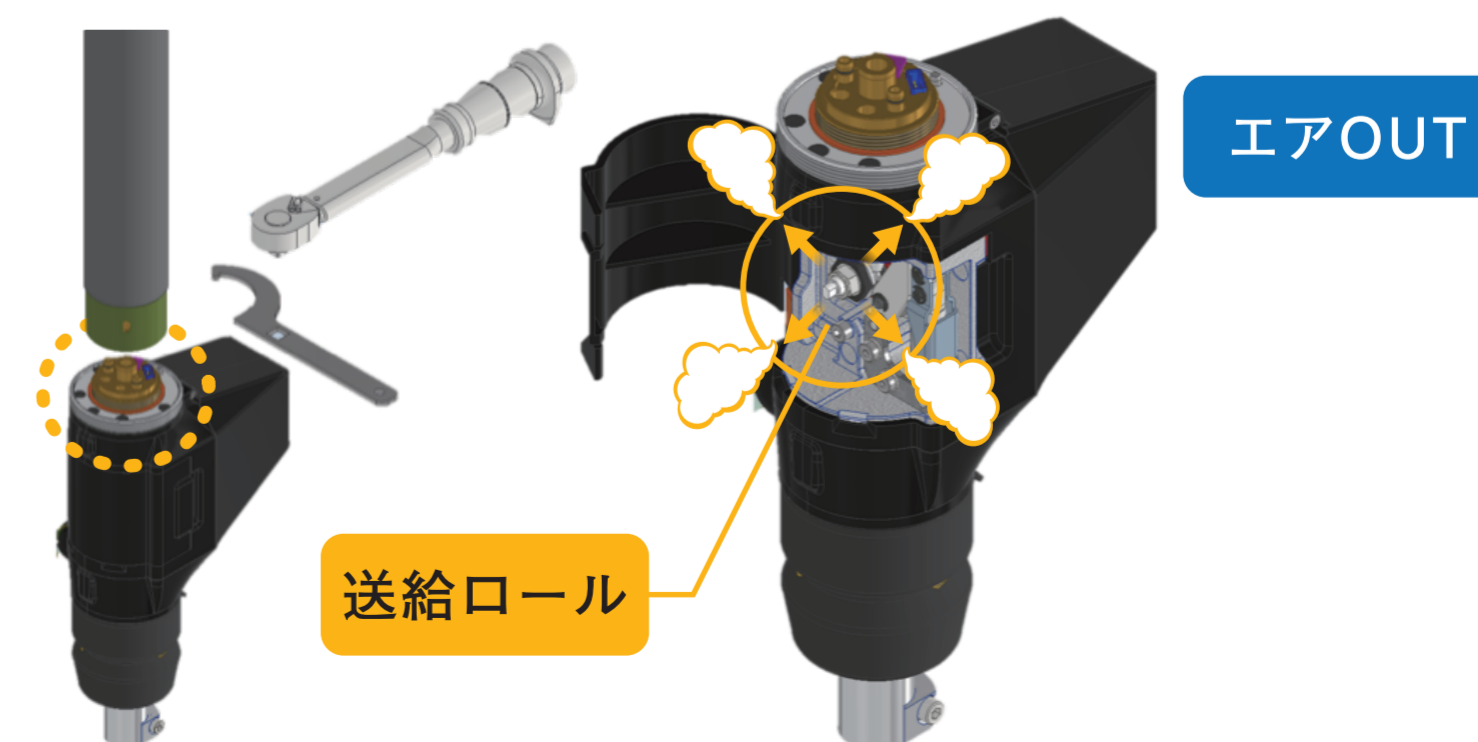


Push Arc



新型プルフィーダ

- ・シンプルで簡単接続
- ・自動清掃機能でメンテナンス性が向上



中文



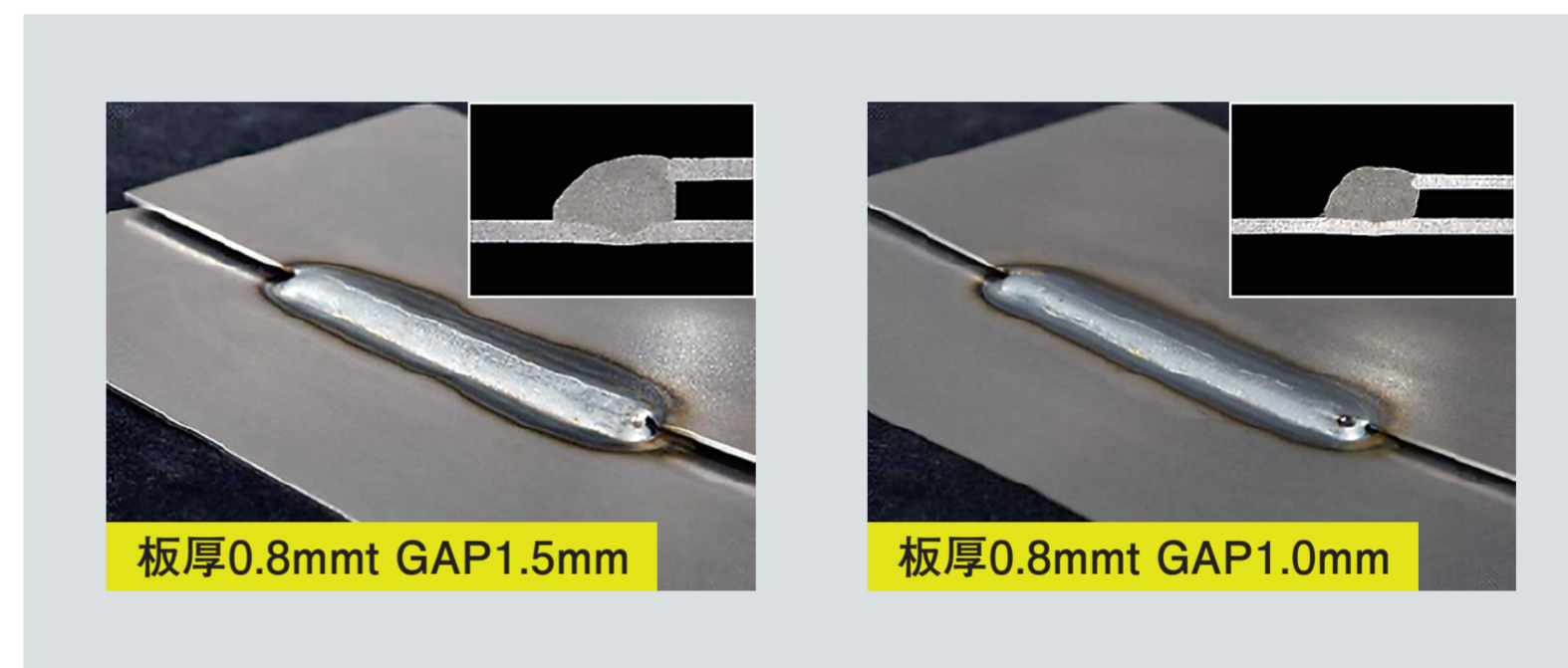
English Edition



交直シンクロフィード溶接法

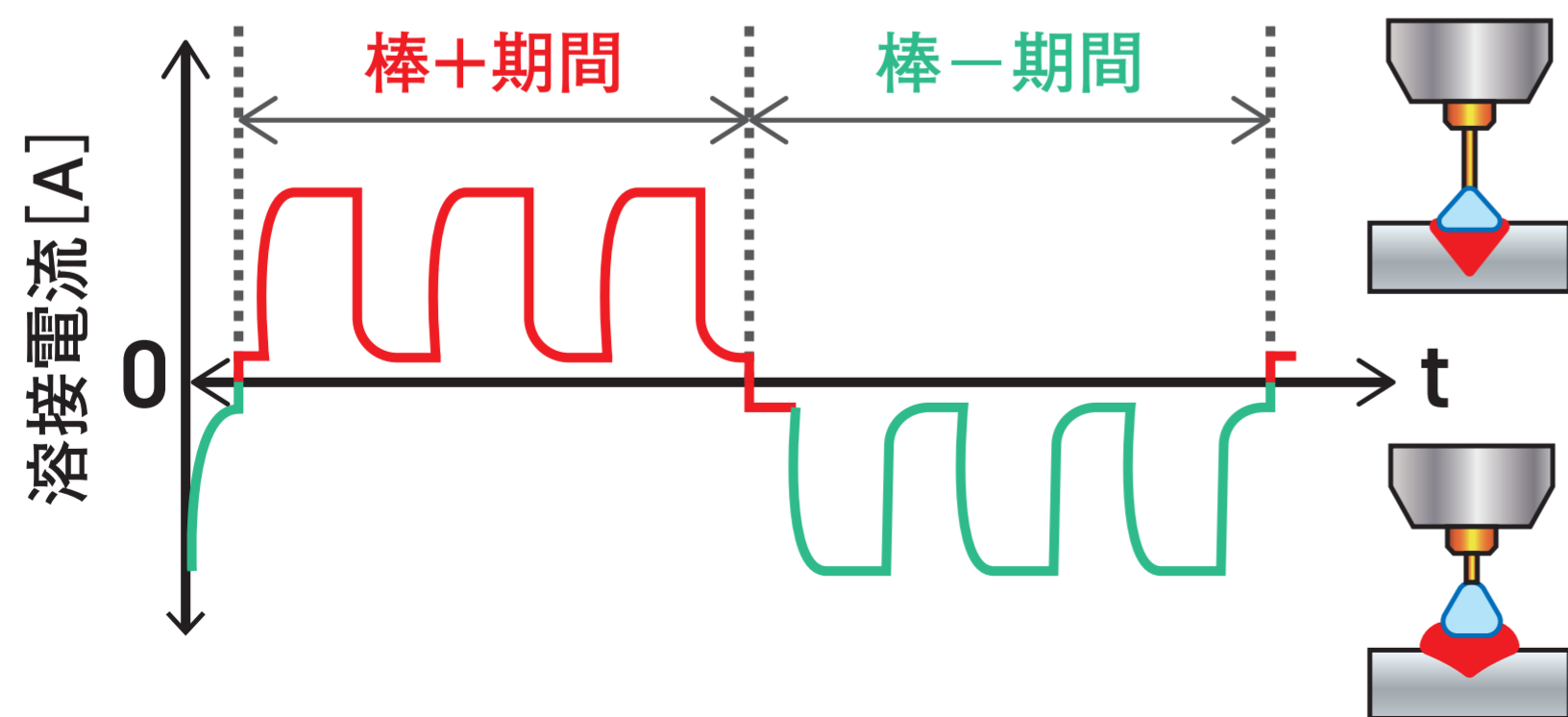
低入熱・高溶着

- ・溶落ちすることなく、極薄板の溶接が可能
- ・板厚以上のギャップでも、簡単に溶接



入熱量と溶着量を細かく調整

- ・「棒+」「棒-」の期間を微調整できる
- ・切替周波数を変更し、好みのビード外観を作製



| 棒-期間 | 0% | 50% | 100% |
|------|----|-----|------|
| 断面図 | | | |
| 入熱量 | 大 | | 小 |
| 溶着量 | 小 | | 大 |